

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202608

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
会议召开方式	上证路演中心网络互动
时间	2026 年 08 月 25 日上午 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：陈仁喜先生 总经理：曾红慧女士 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：林道焕先生 独立董事：赵彤先生
投资者关系活动主要内容介绍	2026 年上半年，公司紧抓 AI 算力需求爆发式增长机遇，在巩固与国内外头部 AI 服务器、数据中心及算力芯片客户深度协作的基础上，持续布局的智能驾驶与存储类市场也取得卓有成效的进展，多赛道协同发力下，高端产品占比显著提升，产品结构持续优化。同时，推动产品价格策略调整，并兼顾客户关系维护与成本上行压力的平衡。得益于对市场机遇的精准把握与内部高效协同，2026 年上半年，公司实现营业收入 190.26 亿元，较上年同期增长 50.05%，归属于上市公司股东的净利润 32.87 亿元，较上年同期增长 130.42%。 线上投资者提出的问题及公司回复情况： 1. 请曾总介绍一下类 ABF 膜的相关研发以及批量投产情况，以

投资者关系活动主要内容介绍	及国产替代情况.谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！公司在较早期就在封装基板用基板材料方面做了相关技术布局，对标该领域内的国际标杆企业，覆盖了不同材料技术路线，并和终端进行专属基板材料开发应用。不同封装形式对材料的要求也不同，我们已在 Wire Bond 类封装基板产品大批量应用，主要应用于传感器、卡类、射频、摄像头、指纹识别、存储类产品领域，并且已在先进封装领域有批量应用，同时已在更高端的以 FC-CSP、FC-BGA 封装为代表的 AP、CPU、GPU、AI 类产品进行开发和应用。谢谢。 2. 请陈董介绍一下苏州 50 亿新基材项目,预计投入和产出情况,谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司苏州生益科技有限公司为推动落实公司战略规划的落地，拟进行扩产项目，与苏州工业园区管理委员会就投资建设新项目达成合作意向，签订意向合作协议，意向投资金额约 50 亿元人民币，具体投资方案在拟定过程中，经相关审批后将及时公告，请投资者届时留意。谢谢。 3. 可以介绍一下在 M10 覆铜板在英伟达认证进展情况吗？目前生益科技有两条技术路线，都介绍一下，谢谢！此外，M9 型号的市场份额大概多少，随着 rubin 的放量，有可能增加吗？预计增加多少？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！公司与国内外各大终端就 AI 领域展开相关项目开发合作，持续为终端和 PCB 客户提供更具有性能挑战的材料。公司高速产品有全系列布局，可以满足不同应用领域的需求。公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，并已有产品在批量供应。公司严格按照法律法规及规范性文件的要求对需披露的信息进行披露，具体经营情况请关注
----------------------	--

	公司定期报告。谢谢。 4. 想跟领导请教下如下问题，感谢 目前对于高速高频新基材的产能、客户认证发展情况，如 M8 材料目前在 ASIC 客户中验证进展。 公司目前扩产进度，如设备和主材供应商验证情况。 公司对于 AI 发展战略，是否会向部分台系厂一样考虑退出部分传统市场 转产 AI 产品。 如何看待传统 FR4 市场供需和涨价的持续性，以及目前电子布等涨价还在持续吗 答：尊敬的投资者，您好！公司与国内外各大终端就 AI 领域展开相关项目开发合作，持续为终端和 PCB 客户提供更具有性能挑战的材料，具体项目进展细节将严格按照有关规定进行披露。 公司目前扩产项目为“松山湖第二工厂”，依据计划有序推进中。 公司以全方位市场及全系列产品的战略布局，提供应用于各个领域的产品，同时也将根据市场需求变化综合考虑调配生产各类型产品。当前公司部分原材料价格已处于历史高位。谢谢。 5. 尊敬的董事长，您好，我是个人投资者，想请教您以下几个问题： 1. 泰国覆铜板项目预计 2026 年下半年试产，何时正式投产，产能 2. 东莞松山湖项目 2026 年 4 月董事会批准，何时建成投产(投资总额约 52 亿元，预计年产能 4,800 万平方米（约 3840 万张）及 10,000 万米商品粘结片,本项目分两期建设) 3. 江西生益二期 2026 年全部投产对公司营收/净利润贡献多大(2025 年 6 月起分批投产，于 2026 年上半年全部投产，可实现年产 1800 万平方米覆铜板及 3400 万米商品粘结片的新增产能。)
--	--

	4. 财务：2026H1 应收账款+存货占资产份额共计 48.93% (31.19+17.74) 5. 2026 半年报 H1 应收账款 132.42 亿, Q1 是 98.21 亿, 2025 年末是 95 亿, 环比分别是+34.66%, +3.1%, 说明 Q2 出货量明显增加 6. 2026 H1 存货 75 亿, Q1mo66 亿, 2025 年末 58 亿, 每季增幅类似, 均约 8-9 亿, 公司如何平衡上游物料涨价和存货问题 谢谢! 答：尊敬的投资者，您好！泰国覆铜板项目预计 2026 年 9 月投产，产能约每个月 40 万张。东莞松山湖项目预计 2027 年下半年陆续投产。江西生益 2026 年上半年实现营业收入约 19 亿元，净利润约 1.85 亿元。公司现有存货为保障订单履约的合理备货，后续将结合市场行情动态调整库存规模，在保障交付的前提下，管控存货跌价风险，优化资金占用。谢谢。 6. 请教下领导， 下游终端客户认证通过后确定 CCL 量产份额，是否会集中选择 1-2 家，主要是出于保供、以及未来参与联合开发的能力、还是更多成本考虑。 目前 M8 和 M9 材料树脂体系，和日系、韩系以及目前台系竞对比优势在哪里 未来贵司在 AI 市场发展规模是否有战略目标，目前作为在 AI 领域后发优势最强的公司，是否会考虑先以低价吃掉日系和韩系的份额 答：尊敬的投资者，您好！公司有全系列高速覆铜板，有不同等级高速覆铜板针对应用在不同传输速率的产品，可以满足服务器、数据中心、交换机、光模块等应用领域的需求，公司与国内外各大终端就 AI 领域的相关应用开展系列项目合作，并提供满足客户需求的产品。公司实施产品技术领先战略，聚焦高端主流市场产品，把握 AI、先进封装、HDI、新能源、卫星通讯、自动
--	---

	驾驶等市场快速发展机会，充分利用外部资源，提升创新研发能力。同时实施多品种发展战略，重点发展高速材料的同时，持续优化做好各类硬板、软板、芯片封装材料。谢谢。
日期	2026 年 08 月 25 日